

職能單元代碼	MPM3R2911v2
職能單元名稱	切割模擬測試與雷射切割
職類別	製造 / 生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	<p>一、料件雷射切割機台模擬測試</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>評估切割料件後，進行光路架設並確認電腦模擬操作。</li> <li>進行光路架設完成模擬並進行驗證。</li> </ol> <p>二、切割機台定位</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>機台原點復歸及定位工作原點。</li> <li>判定機台或鏡頭的堪用程度。</li> <li>設定氣體壓力進給速度切削功率等切割條件。</li> </ol> <p>三、雷射切割打樣操作</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>依據客戶提供產品各種材質，進行材料切割條件的判定。</li> <li>根據實驗測試結果，分析實驗數據。</li> <li>根據擬定的實驗規劃，執行產品打樣及測試並產出測試報告書。</li> </ol> <p>四、雷射切割製程操作</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>依據工作圖面進行工作分析與操作。</li> <li>依製程進行實務切動作業。</li> </ol>
工作產出	<ul style="list-style-type: none"> <li>打樣測試報告書</li> </ul>
職能內涵 (K=knowledge知識)	<ul style="list-style-type: none"> <li>光路架設概論</li> <li>切割機台調校概論</li> <li>雷射加工特性分析方法</li> <li>品質管制方法</li> <li>光學料件概論</li> <li>光路架設概論</li> <li>職業安全衛生相關規範</li> <li>精密量測概論</li> </ul>
職能內涵 (S=skills技能)	<ul style="list-style-type: none"> <li>製作夾(治)具能力</li> <li>文書撰寫能力</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 料件打樣操作能力</li><li>• 切割機台操作能力</li><li>• 雷射切割操作能力</li><li>• 雷射切割模擬測試操作能力</li><li>• 個人防護裝備使用能力</li></ul>
說明與補充事項	無